

FusionServer

X6000 V6 高密服务器



FusionServer

X6000 V6高密服务器





X6000 V6 (8盘)

X6000 V6 (24盘)

FusionServer X6000 V6服务器是针对ISP客户、HPC客户做了架构优化,是服务器大规模部署的理想选择,是为互联网、HPC、云计算、数据中心等业务应用需求而推出的新一代2U高密度服务器产品。专注应用于软件定义存储、大数据和SDI基础架构。



高密计算,极致性能

- 计算密度是传统1U机架服务器的2倍、传统2U机架服务器的4倍
- 支持最多24块NVMe SSD存储



汇聚管理, 便捷维护

- 采用各节点iBMC协同管理方式,融合了刀片和机架的优点,节点后置,后出线
- 模块化设计, 硬盘、节点、电源、OCP卡、风扇 支持热插拔, 大幅提升运维效率



共享架构、高效节能

- 服务器节点共享4个电源,支持1+1或2+2冗余,整框最高支持4个3000W电源模块
- 硬盘连接采用无背板设计,系统散热能力提升20%
- 大尺寸VC连体散热器,采用相变均温VC技术,导热系数提升15倍以上

形态	2U4节点机框
节点系统	支持4个1U半宽双路服务器节点
电源	支持4个1200W、1500W、2000W或3000W AC电源模块,支持1+1或2+2冗余*和热插拔
供电	支持100~240V AC,240V DC
风扇	支持4个8080+风扇模块,支持N+1冗余和热插拔
工作温度	5°C - 45°C(41°F-113°F)(符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4)
产品认证	CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RoHS等
尺寸(宽x深x高)	447mm*899mm*86.1mm

^{*}依据整机功耗和单电源功率不同关系,X6000电源配置支持不同场景的1+1、2+2电源冗余

XH321 V6服务器节点



FusionServer XH321 V6是超聚变新一代1U半宽双路服务器节点,为突破能源限制、提升系统存储密度进行创新设计,具有强大的计算能力、超高的存储密度、易管理易维护等特点,适合数据中心,云计算,大数据和互联网等多种应用场景。



卓越计算性能

- 支持最多2个第三代英特尔[®] 至强[®]可扩展处理器,支持TDP高达270W的系列最高性能处理器
- 支持8内存通道,内存带宽提升45%
- 支持全NVMe SSD加速和2+4均衡设计,消除IO瓶颈



适配灵活部署

- 支持InfiniBand HDR 200高速网络互联
- 支持2*M.2 SSD提供高速可靠OS启动盘

形态	1U半宽双路服务器节点
处理器型号	2个第三代英特尔 [®] 至强 [®] 可扩展处理器6300/8300系列,最高270W
内存插槽	16个DDR4 DIMM插槽,最高3200MT/s,内存容量可达2TB(配置128GB内存)
本地存储	支持最多6个2.5" SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘,NVMe支持2+4均衡 支持最多两个M.2 2280或2242 SATA SSD 支持不同硬盘类型的混合配置
RAID支持	支持RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60和超级电容掉电保护 支持M.2 SSDs构建RAID 0, 1
PCle扩展	支持2个PCIe 4.0x16 半高半长的标准扩展插槽
OCP扩展	支持1个OCP扩展插槽
管理	 iBMC芯片集成1个专用管理GE网口,提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口;提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面;支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度 提供一个汇聚管理网口,将4个计算节点汇聚到一个管理接口简化管理 可选配超聚变FusionDirector管理软件,提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性,实现全生命周期智能化、自动化管理
支持的操作系统	Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESXi、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Oracle、Ubuntu、Debian等
工作温度	5°C - 45°C (41°F-113°F) (符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4)
产品认证	CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RoHS等
尺寸(宽x深x高)	218.7mm x 632mm x 40.7mm

超聚变数字技术有限公司 02

XH321C V6服务器液冷节点



FusionServer XH321C V6是最新一代1U半宽双路服务器液冷节点,支持CPU和内存液冷散热,支持45°C温水散热。机柜级全液冷方案,散热比高达100%,PUE≤1.05;板级液冷方案,散热比高达80%,PUE≤1.1。



高能效、高可靠

- CPU采用微通道冷板,内存间冷板走水优化设计,板级液冷散热比例高达80%
- 支持45°C温水散热, TCO降低20%
- 支持系统水路、电路隔离设计, 异常状态监控



机柜级部署方案

- 适配FusionServer液冷机柜,柜内集成manifold,支持与总管快速对接
- 液冷机柜最多支持72个液冷节点

形态	1U半宽双路液冷服务器节点
处理器型号	2个第三代英特尔 [®] 至强 [®] 可扩展处理器6300/8300系列,最高270W
内存插槽	16个DDR4 DIMM插槽,最高3200MT/s,内存容量可达2TB(配置128GB内存)
本地存储	支持最多6个2.5" SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘,NVMe支持2+4均衡 支持最多两个M.2 2280或2242 SATA SSD 支持不同硬盘类型的混合配置
RAID支持	支持RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60和超级电容掉电保护 支持M.2 SSDs构建RAID 0, 1
PCIe扩展	支持1个PCIe x16 半高半长的标准扩展插槽
OCP扩展	支持1个OCP扩展插槽
管理	 iBMC芯片集成1个专用管理GE网口,提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性 iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口;提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面;支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度 提供一个汇聚管理网口,将4个计算节点汇聚到一个管理接口简化管理 可选配超聚变FusionDirector管理软件,提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性,实现全生命周期智能化、自动化管理
支持的操作系统	Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESXi、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Oracle、Ubuntu、Debian等
工作温度	5°C - 45°C(41°F-113°F)(符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4)
产品认证	CE、UL、FCC、CCC、VCCI、RoHS等
尺寸(宽x深x高)	218.7mm x 632mm x 40.7mm (不包含液冷进出水管部分)

超聚变数字技术有限公司

咨询电话: 400-080-6888 技术服务热线: 400-009-8999

地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛正商博雅广场 1号楼 9层

网址: www.xfusion.com

版权所有 © 超聚变数字技术有限公司 2022。保留一切权利。 非经超聚变数字技术有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

∝FUSION 、超聚变是超聚变数字技术有限公司的商标或者注册商标。在本手册中以及本手册描述的产品中,出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称,由其各自的所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,超聚变数字技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。